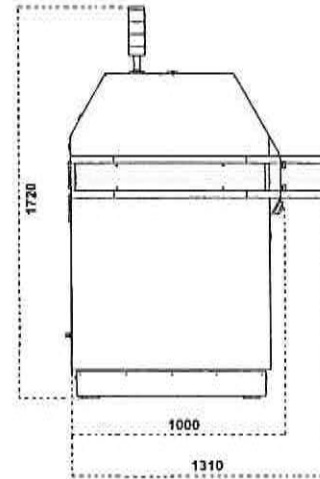
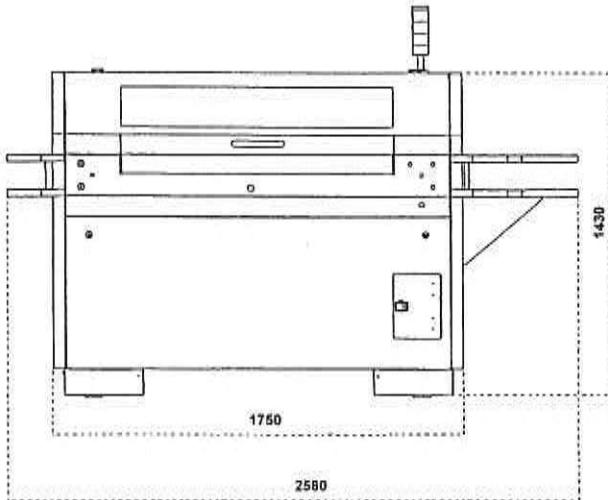


## 5.14 Technische Daten A 3



### Mechanik

Grundgestell mit 8 Testköpfen (4 Köpfe pro Seite)  
 Pentium Hardware mit WinNT-Betriebssystem  
 Variables Produktaufnahmesystem  
 Synchroner Test mehrerer Leiterplatten  
 Aktiver Testbereich: 520 mm x 400 mm (20,4 in x 15,7 in)  
 Max. Prüflingsgröße: 610 mm x 457 mm (24,0 in x 18,0 in)  
 Leiterplattenstärke bis 6 mm

### Optische Registrierung

2 Kameras für optisches Scannen von oben und unten mit Verzugskompensation  
 Optische Abbildung ca. 8 mm x 6,5 mm mit  
 10 µm/Pixel Auflösung

### Elektrische Parameter

2-Punkt-Verbindungsmessung ab 1 Ω (±2 %)  
 100 % Isolationstest mit 10 MΩ nach Feldmessmethode (ohne Adjacency)

### Mechanische Parameter

Positioniergenauigkeit in X- und Y-Richtung: ±35 µm  
 Wiederholgenauigkeit: ±10 µm  
 Kleinster Testpunkt: 100 µm (4 mil)  
 Andruckkraft programmierbar: 20 - 100 g